

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и Дата

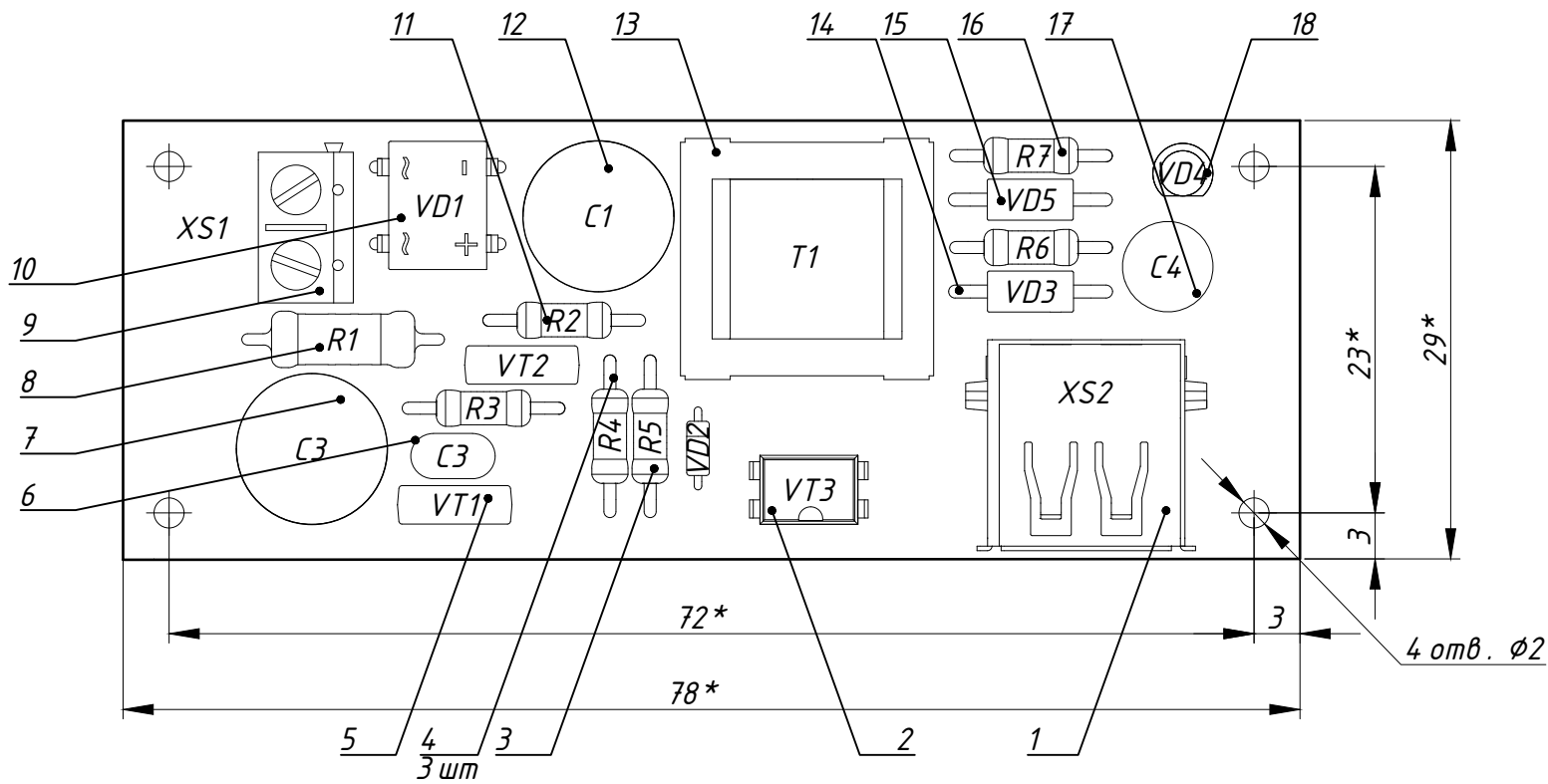
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

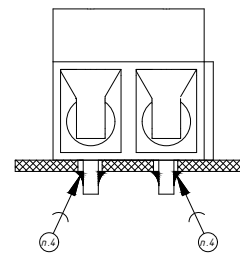
Подп. и Дата

Инв. № подл

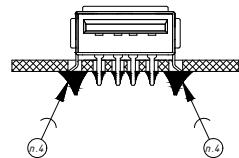
ИУ 4.11.03.03.19.05.02.003 ЭЗ



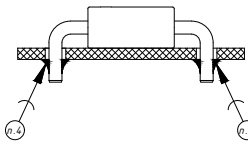
Установка разъема XS1



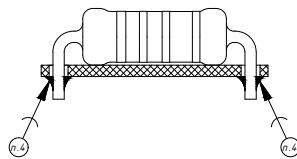
Установка разъема XS2



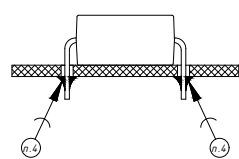
Установка стабилитрона VD5



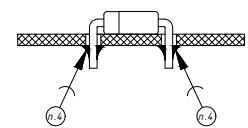
Установка элек. конденсаторов C1, C2, C4



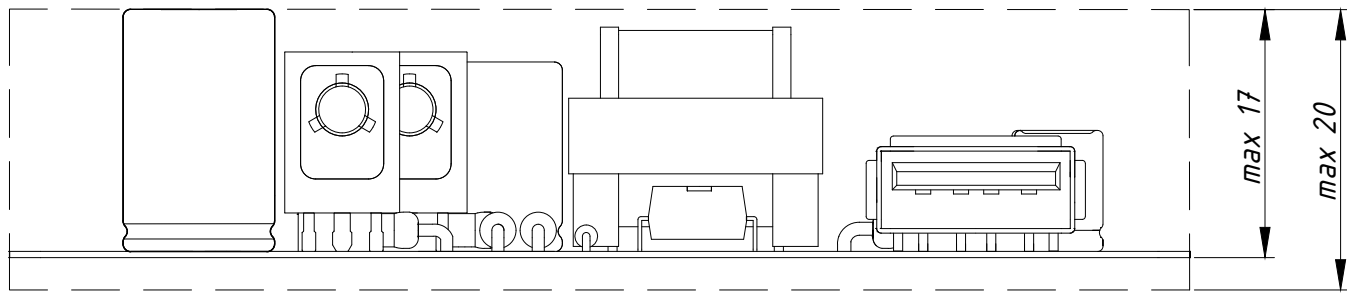
Установка конденсаторов C3



Установка диода VD2



- Размеры для справок
- Печатные проводники не показаны.
- Обозначение элементов показаны условно.
- Монтаж выполнить согласно схеме ИУ 4.11.03.03.19.05.02.003 ЭЗ
- Установку новестных элементов производить по ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 класс В , припой п.5, располагая их симметрично относительно контактных площадок . Для компонента типа "чип" допускается выход компонентов за пределы контактной площадки не более 0,05 мм.
- Минимальный допустимый зазор между соседними компонентами поверхностного монтажа (включая зоны паяк, выводов и торцы компонентов) должен быть не менее 0,2 мм.
- Установка выводных разъемов осуществлять по ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010.
- Пайку КМО производить согласно ГОСТ 23592-96 , припой п.5 .
- ПОС -61 ГОСТ 21930-76.
- После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто -бензиновой смесью ГОСТ 18300-87 .
- Контроль паяных соединений производить визуально - оптическим методом по ГОСТ 24715-81 .
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070 .015 .



					ИУ 4.11.03.03.19.05.02.04.005 СБ					
					Блок питания Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
								0,15	2:1	
						Лист		Листов 1		
						МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ 4 Группа ИУ 4-52 Б				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.		Исмаилов А.К								
Пров.										
Т.контр.										
Реценз.										
Н.контр.		Сергеева М.Д								
Утв.		Семенцов С.Г.								